## 國立交通大學

## 材料科學與工程研究所 碩士論文

覆晶封裝銲錫技術中 熱時效對電遷移效應的影響 Effect of Aging on Electromigration of Flip-Chip Solder Joints

指導教授:陳智博士

研究生:張哲誠

學號: 9318519

中華民國九十五年七月

## 覆晶封装銲錫技術中熱時效對電遷移效應的影響

## Effect of Aging on Electromigration of Flip-Chip Solder Joints

指導教授:陳 智 博士 Advisor: Dr. Chen Chih

研究生:張哲誠 Student: Che-Cheng Chang

國立交通大學

材料科學與工程學系所

碩士論文

A Thesis

Submitted to Department of Materials Science and Engineering

College of Engineering

National Chiao Tung University

in partial Fulfillment of the Requirements

for the Degree of

Master

in

Materials Science and Engineering
July 2006

Hsinchu, Taiwan, Republic of China

中華民國九十五年七月